|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  | 月 |  | 日 |

株式会社富士通総研　殿

|  |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 名称 |  |
| 代表者氏名 |  |

**令和5（2023）年度「ICT海外展開パッケージ支援事業の地方枠」**

**公募申請書**

標記の件について、次のとおり必要書類を添えて申請します。

1. 提案書

2. 登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写しなど法人の概要が分かる説明資料（募集要領2.(2)関係）

|  |
| --- |
| （担当者欄） |
| 所属部署名： |  |
| 役職名： |  |
| 氏名： |  |
| TEL： |  |
| FAX： |  |
| E-Mail： |  |

**注：申請は、法人単位での提出となります。同一法人で複数の事業所等から申請をしようとする場合には、法人で1つに取りまとめて申請してください。**